



台光電子材料股份有限公司

全球環保暨高階基材的領航者

法人說明會簡報

114年7月

*Innovation
Globalization
Diversification*



免責聲明

本簡報之內容可能包括本公司基於從各項來源所取得的資訊，對於營運、財務狀況與企業發展情形的前瞻性預估。

因為包括但不限於市場需求、價格波動、競爭態勢、供應鏈變動、全球經濟局勢、匯率波動及其他本公司無控制力之風險等各種因素，實際的營運、財務狀況與企業發展情形，可能會與本公司於預測中明示或默示敘述有差異。

本簡報之內容若有對未來之前瞻性預估，僅反映本公司於發佈當時之看法。本公司並無義務於日後情況變更時，更新前瞻預估。

會議議程

01	第二季營運成果	04
02	領先同業持續擴大	07
03	台光電成長優勢 • 技術 • 規模 / 生產據點分散	10
04	問答時段	14

第二季綜合損益表

綜合損益表項目

(除另予註明者外，金額為新台幣百萬元)

	2Q25	1Q25	2Q24	季變化	年變化
營業收入	22,508	21,680	15,449	3.8%	45.7%
營業毛利	6,829	6,590	4,235	3.6%	61.3%
營業利益	4,644	4,540	2,924	2.3%	58.8%
繼續營業部門稅前淨利	4,467	4,667	2,975	-4.3%	50.1%
所得稅費用	(989)	(1,200)	(542)	-17.6%	82.6%
稅後淨利	3,478	3,467	2,434	0.3%	42.9%
基本每股盈餘(新台幣元)	10.02	10.01	7.08	0.1%	41.5%
營業毛利率(%)	30.3%	30.4%	27.4%	-0.1 pts	+2.9 pts
營業利益率(%)	20.6%	20.9%	18.9%	-0.3 pts	+1.7 pts
稅後淨利率(%)	15.5%	16.0%	15.8%	-0.5 pts	-0.3 pts
股東權益報酬率	38.2%	41.7%	34.0%		

第二季資產負債表及重要財務指標

資產負債表項目 (新台幣百萬元)

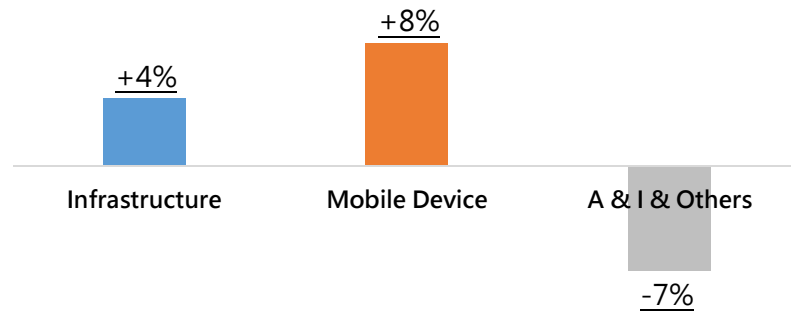
	2Q25		1Q25		2Q24	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金	17,620	20.1%	18,427	21.1%	13,514	20.7%
應收帳款+應收票據	30,564	34.9%	30,239	34.6%	20,724	31.8%
存貨	10,936	12.5%	10,558	12.1%	7,771	11.9%
不動產、廠房及設備	24,137	27.6%	23,842	27.3%	18,399	28.2%
資產總計	87,611	100.0%	87,415	100.0%	65,184	100.0%
短期借款	8,957	10.2%	9,040	10.3%	10,969	16.8%
應付帳款	17,014	19.4%	18,053	20.7%	12,970	19.9%
長期借款	9,114	10.4%	11,385	13.0%	1,634	2.5%
業主權益	36,391	41.5%	33,272	38.1%	28,644	43.9%
負債及權益	87,611	100.0%	87,415	100.0%	65,184	100.0%
重要財務指標						
平均收現日數	117		118		125	
平均銷貨日數	60		60		64	
流動比率 (倍)	1.5		1.5		1.3	

第二季銷售分析-產品組合

基礎設施的強勁增長反映高端材料市佔率提升

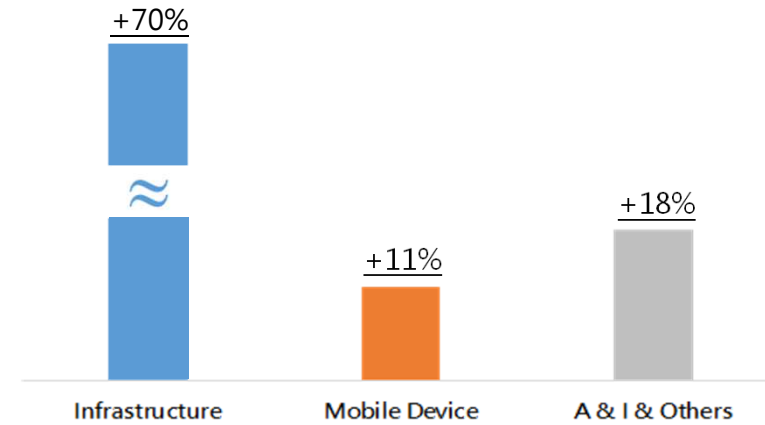
第二季營收成長：4% QoQ

季變化



第二季營收成長：46% YoY

年變化

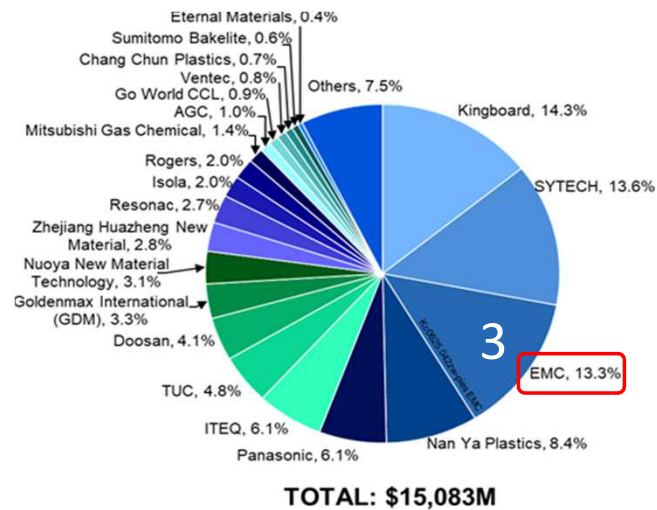


領先同業持續擴大

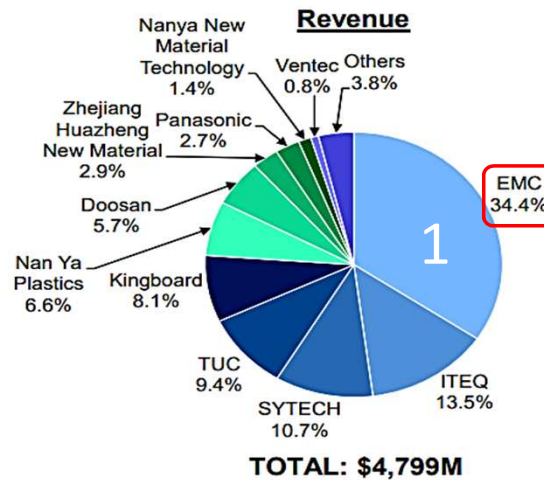
高階市場市佔擴大領先

- Global **No. 1** – mSAP, HDI Laminate provider
- Global **No. 1** – High-Speed Green Laminate provider

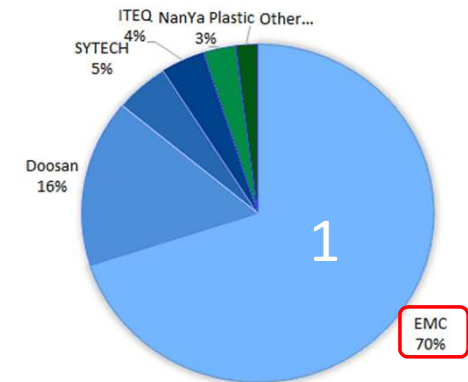
Laminate Market



Green Laminate Market



HDI Laminate Market

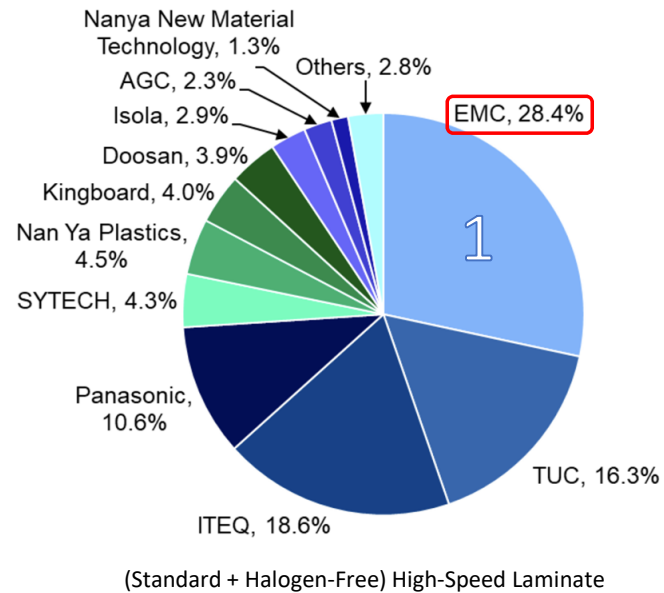


- By Revenue
- Mass Lam Sales is excluded.

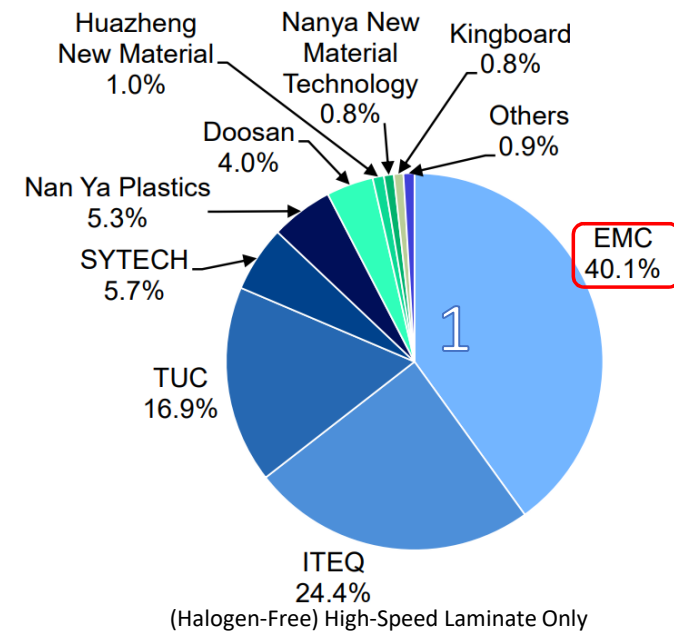
領先同業持續擴大

2023 年高速材料全球排名第一，且市佔率持續成長中

2023



2024

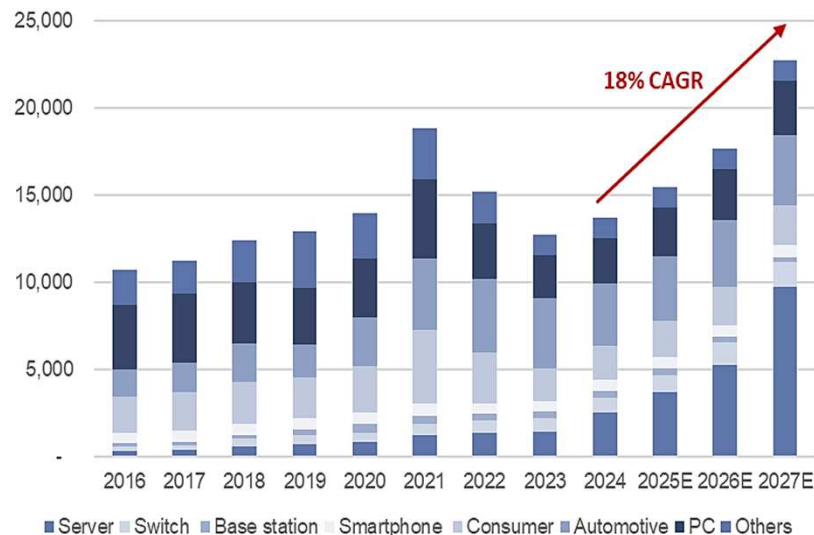


領先同業持續擴大

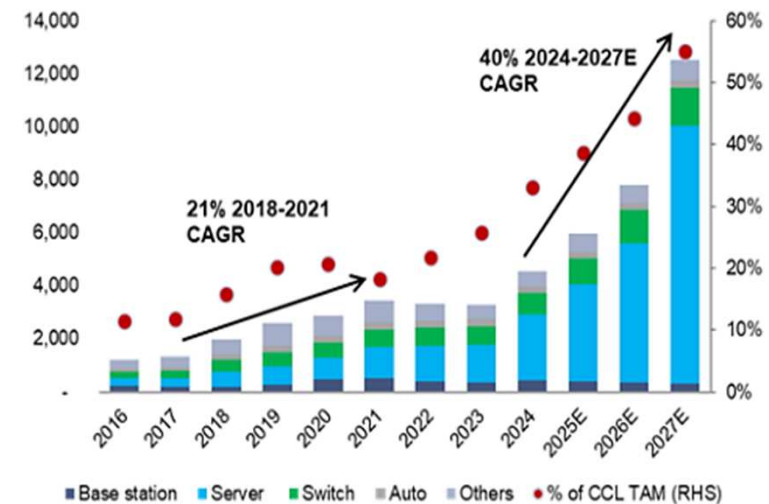
高階CCL (HDI & 高速高頻)

- 高階銅箔基板市場年複合成長率 **40%** (2024-2027)
- 銅箔基板市場年複合成長率 **18%** (2024-2027)
- 台光電成長率將高於高階銅箔基板市場

Overall CCL Market



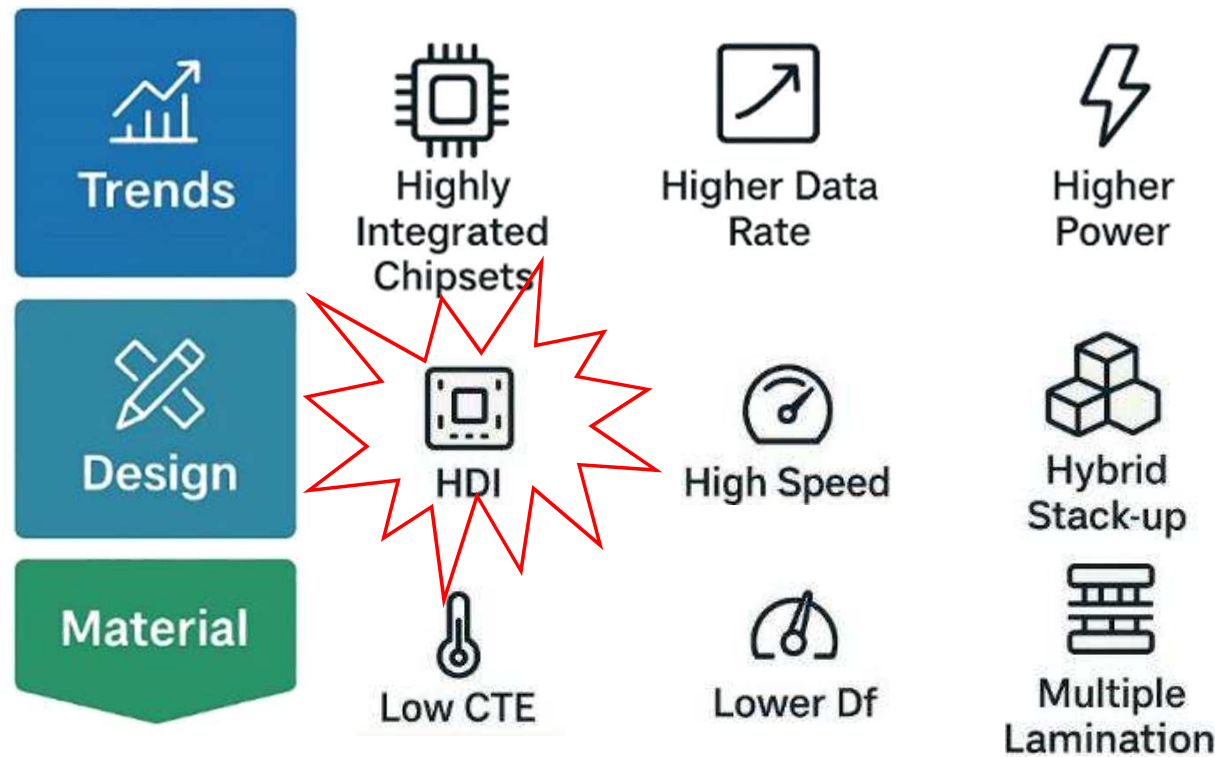
High-Speed CCL Market



Source: Goldman Sachs Global Investment Research, July 2025

台光電成長優勢

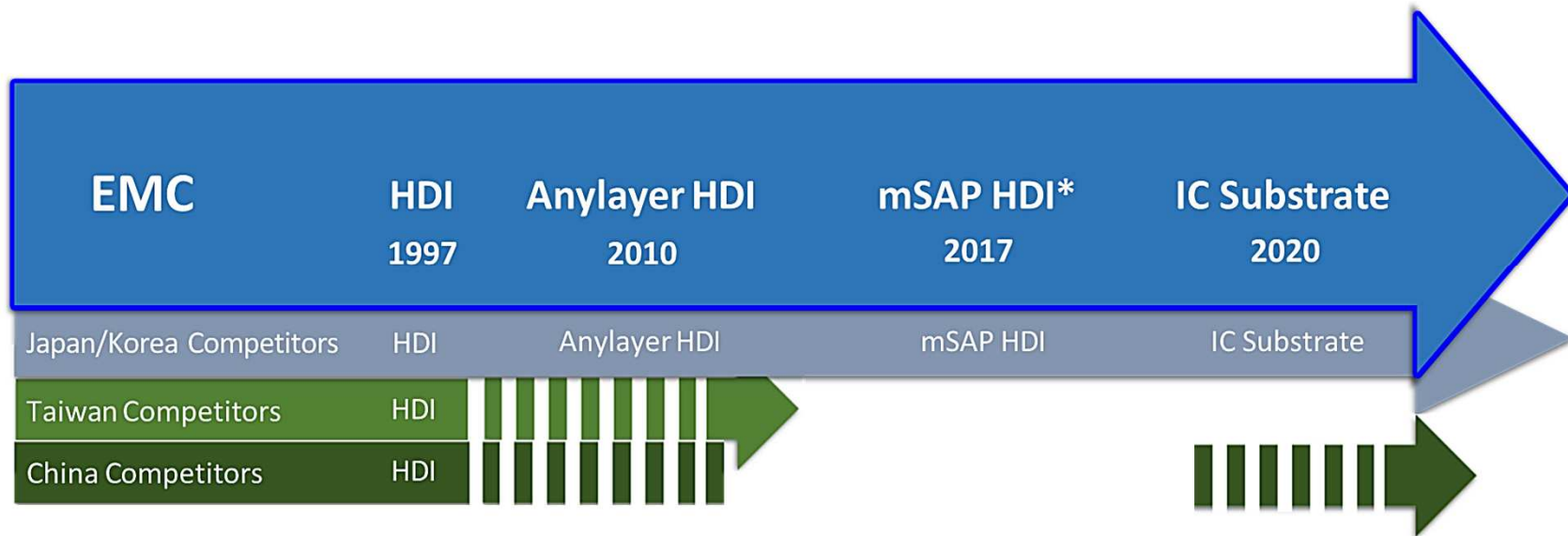
AI 基礎設施設計趨勢



台光電成長優勢

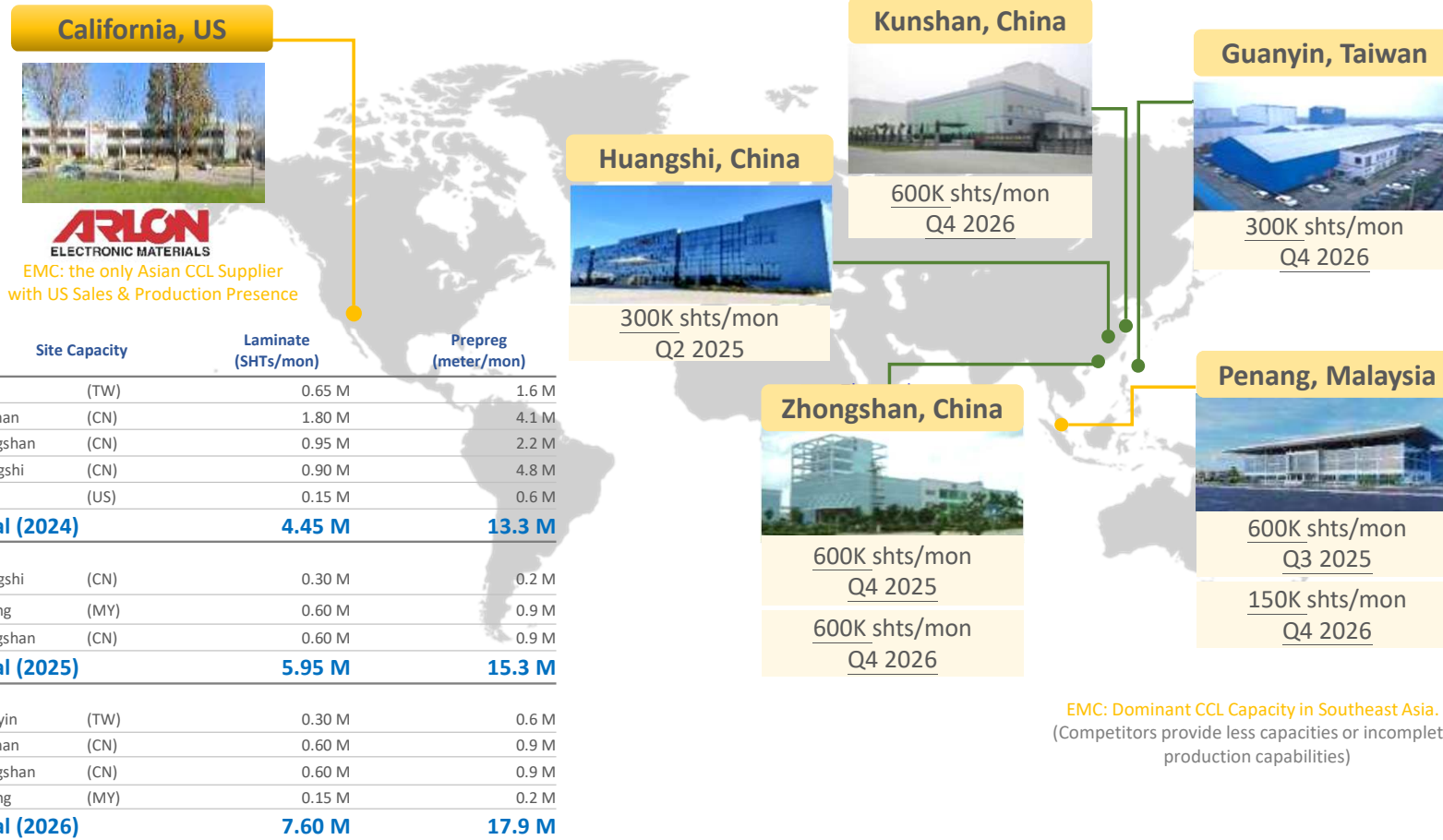
HDI 技術領先

The only mSAP and substrate maker outside Japan/Korea with 100% proprietary technology



台光電成長優勢

規模及全球佈局



永續報告

公司治理評鑑提升至前 6 - 20%

以2023年為基準年，2030年達成減碳30%



Q & A